

itlepage

**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Rio Grande do Sul

Roteiro da Apresentação

Inovação: A Formulação Binder-Free

Reologia e Estabilidade da Tinta

Desempenho Térmico e Mecânico

Conclusão

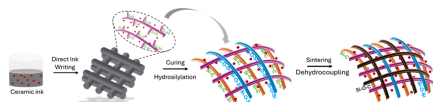
Referências

O Desafio da Manufatura Aditiva de Cerâmicas

- As Cerâmicas de Carbetto de Silício (SiC) são críticas para aplicações aeroespaciais devido à alta resistência e resiliência térmica [2, 3].
- O processo DIW (Direct Ink Writing) é promissor, mas a maioria das tintas depende de:
 - **Ligantes (Binders):** Exigem *de-binding* térmico, causando retração irregular e rachaduras [4].
 - **Solventes:** Voláteis, introduzem toxicidade, e sua evaporação induz instabilidades estruturais (empenamento, microfissuras e poros) [4].

Inovação Central do Artigo

- **Abordagem Livre de Solventes e Ligantes (*Solvent- and Binder-free*)** [2, 5].
- **Material Chave:** Utilização do polycarbosilano **SMP-10** [5].
 - O SMP-10 atua como o **precursor cerâmico** e a **fase líquida** para ligar as nanopartículas de β -SiC [2, 5].
 - Simplifica o pós-processamento, minimizando defeitos estruturais [4, 5].



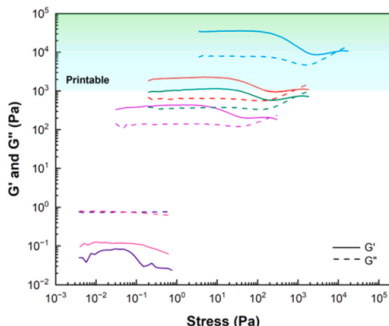
Esquema do processo DIW livre de ligantes e solventes.

Otimização Reológica para o DIW

- A tinta ideal deve ser **shear-thinning** para extrusão suave [6].
- Deve ter elasticidade suficiente para **reter a forma** após a deposição [6, 7].

Critério de Printabilidade (Ponto de Gel):

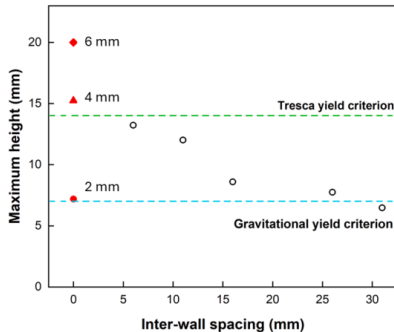
- O critério crucial é o **Ponto de Gel** ($G' = G''$) ser **superior a 1000 Pa** [8, 9].
- **Resultado:** A tinta com **60 wt% SiC** mostrou excelente retenção, superando o limite [9, 10].



Curvas de Módulo de Armazenamento (G') e Módulo de Perda (G'') em função do *stress* (Ponto de Gel).

Limites de Estabilidade Estrutural (h_{max})

- O artigo investigou a **Altura Máxima Imprimível (h_{max})** [11, 12].
- **Suporte Lateral (d_w):** Maior espaçamento levou a h_{max} reduzida (≈ 7 mm). O espaçamento reduzido é crucial para estruturas mais altas [14, 15].
- **Largura da Camada Base (l_w):** Camadas base mais largas aumentaram a h_{max} (≈ 20 mm) [2, 16].



Imagens das estruturas impressas (SEM) e gráfico da altura máxima (h_{max}) versus espaçamento de parede (d_w).

Modelos Teóricos: Delimitam os limites inferior (≈ 6.62 mm) e superior (≈ 14 mm) [18, 19].

Transformação de Fase e Retração

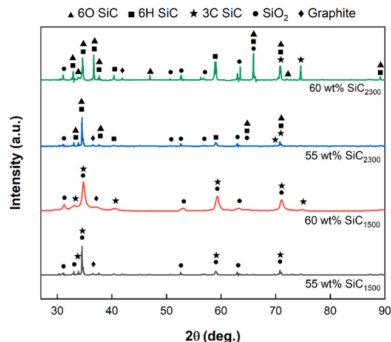
■ Pós-Processamento:

Sinterizadas a 1500°C e 2300°C [20].

■ Fases (XRD): β -SiC

predominante a 1500°C.
Transformação para α -SiC a 2300°C [21].

■ Retração: A 2300°C, a retração é maior e anisotrópica, com alta retração fora do plano ($\approx 17\%$) [15, 22].



Padrões de Difração de Raios X (XRD) comparando as fases a 1500°C e 2300°C.

Propriedades Mecânicas e Térmicas

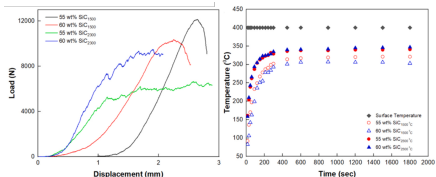
Resistência Mecânica

(Compressão):

- 1500°C apresentou **maior resistência** (9.62 ± 1.10 MPa) do que 2300°C (5.62 ± 1.75 MPa) [23].
- **Explicação:** A retração anisotrópica a 2300°C causa **distorção arquitetônica** [23].

Isolamento Térmico:

- Amostras a 1500°C **demonstraram excelente isolamento** devido à microestrutura mais porosa [24].



Comparação da resistência à compressão e do desempenho de isolamento térmico.

Conclusões Chave

- O método **DIW livre de solventes e ligantes** é uma abordagem conveniente e eficiente para cerâmicas avançadas [2, 15].
- A **reologia** é o fator limitante. A printabilidade ideal requer um **Ponto de Gel** $> 1000 \text{ Pa}$ [8, 25].
- A **estabilidade estrutural** é altamente dependente da geometria [2, 15, 26].
- **Resultado Surpreendente:** O tratamento térmico a 1500°C forneceu **melhores propriedades mecânicas e isolamento térmico** do que a 2300°C [23, 24].

Relevância e Perspectivas Futuras

- Este trabalho fornece a fundação para equilibrar printabilidade, isolamento térmico e desempenho mecânico [15].
- O uso do DIW com formulações livres de solventes aprimora o controle sobre a evolução microestrutural [2, 15].

Referências

- VISWANADHA, P. et al. Solvent- and binder-free additive manufacturing of polymer-derived ceramics: Rheological optimization and structural performance. *Additive Manufacturing*, v. 84, p. 104278, 2025.

Obrigado.